

金誉半导体

深圳市金誉半导体股份有限公司，成立于2011年，是一家致力于半导体产业的国家高新技术企业，主要从事集成电路及其应用解决方案的研发设计、集成电路的封装、测试和销售，面向全球提供半导体产品&服务。

包括DFN/QFN/PDFN//TO/SOD/TSSOP/SOP/SOT/等多个集成电路封测产品系列，拥有电源管理IC、MOSFET、单片机和功率器件等千余种产品，应用于智能家电、手机及平板、充电&适配器、LED照明、智能电表、工控设备等领域。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/jybd-745122.html>